

技術詞彙

本詞彙表載有本文件所用與本公司我們的其業務有關的若干詞彙的解釋。本詞彙表所載術語及其涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法一致。

「執行器」	指	控制系統中的一個組件，其將能量源轉化為物理運動或機械動作來控制設備或系統
「AI」	指	人工智能
「算法」	指	用於解決特定問題或進行計算的定義明確的有限指令或規則序列
「功放」	指	一種可增強訊號功率的電子設備，為一個二埠電子電路，使用來自供電系統的電力以增強應用於輸入端的訊號的振幅（電壓或電流的幅度），從而產生比例較大的振幅訊號作為輸出
「類比」	指	電壓、電流或物理量的訊號，其根據若干時變參數而持續變化
「平均售價」	指	平均售價
「擴增實境」或「AR」	指	一項通過手提設備或佩戴於頭上的顯示器，將實時3D渲染電腦圖像覆蓋部份現實世界的技術
「音頻功放」	指	一種能提高音頻信號的功率、電壓或電流的電子裝置或電路，使其能有效驅動揚聲器或耳機
「音頻編解碼器」	指	壓縮及解壓縮數字音頻數據的硬件或軟件組件，允許更小的文件大小及更有效的傳輸及存儲
「BCD」	指	一系列的硅製程，其包括雙極、CMOS及DMOS技術，各項將三種不同製程技術的優點整合到同一芯片上
「對焦虛化」	指	一個攝影術語，指攝影圖像中失焦部分的模糊美感
「背照式」或「BSI」	指	一款數字圖像感測器，使用新型圖像元件排列以增加捕獲的光量，從而提升弱光下的成像性能
「複合年增長率」	指	複合年增長率

技術詞彙

「芯片」	指	一小塊半導體緊湊組件，在單個半導體芯片上包含多個相互連接的組件，亦稱為集成電路或微芯片
「CMOS」	指	互補式金屬氧化物半導體
「CoE」	指	色彩濾鏡封裝技術，一種用於可摺疊OLED顯示屏的技術
「CPU」	指	中央處理器，一部電腦內的主要處理器
「設計導入」	指	為允許OEM設備集成其他供應商的產品而執行的工程、技術及其他支持
「數位」	指	以一連串離散值代表數據的訊號
「數字孿生」	指	為準確反映物理對象而設計的對象或系統的一種虛擬表示
「數位訊號處理器」或「DSP」	指	一款特製微處理器芯片，其架構專為配合數位訊號處理的運作需求而優化
「直接ToF」或「dToF」	指	ToF感測器使用的一種技術，以直接測量光脈衝傳到目標再返回所需的時間
「EDA」	指	電子設計自動化，一種用於設計芯片及印刷電路板等電子系統的軟件工具。芯片設計師在設計流程中運用各款工具，以設計及分析整塊半導體芯片
「ESD」	指	靜電釋放，為當兩個帶不同電荷的物件相互靠近，或兩者間的電介質遭到破壞時突然及瞬間出現的電流，通常會產生與物件間靜電相關的可見火花
「基本頻率」或「F0」	指	複雜週期波形的最低頻部份，通常被視為音高
「F0檢測」	指	對F0的估計
「無晶圓廠」	指	一種業務模式，指實體專注於研發及設計芯片，並將生產外包予外部人士
「濾鏡」	指	將若干不需要的元表或特色從訊號中移除的設備或過程
「閃爍」或「Flicker」	指	視訊顯示器上顯示的周期之間亮度的可見變化

技術詞彙

「晶圓廠」	指	生產集成電路的工廠
「霍爾靈敏度」	指	感測器將磁場轉換為霍爾效應感測器中的可計量電壓的效率，其顯示某一特定磁場強度變化下的輸出電壓變動
「觸覺核心波形生成演算法」	指	用於生成觸覺設備提供的特定振動模式和觸覺感受的方法。觸覺設備是讓用戶能夠透過觸覺與數位內容或環境互動的技術
「人機交互」	指	人們操作及使用計算機系統的過程
「集成電路」或「芯片」	指	於一小片半導體物料（芯片）上的一組電子電路
「智能感知芯片」	指	用於智能裝置中，以收集各類環境資訊並提供回饋的芯片
「吋」	指	用於標示晶圓直徑的度量標準單位。於半導體行業，晶圓的一般尺寸包括2吋（50毫米）、3吋（75毫米）、4吋（100毫米）、6吋（150毫米）、8吋（200毫米）及12吋（300毫米）
「物聯網」或「IoT」	指	具備感測器、處理能力、專件及其他技術的實物物件（或實物物件組合），以與互聯網或其他通訊網絡的其他設備及系統連接並交換數據
「ISP」	指	影像訊號處理器，一個影像處理電路
「間接ToF」或「iToF」	指	ToF感測器使用的一種技術，以間接測量調制光訊號的相位偏移調變
「LCD」	指	液晶顯示器，指利用液晶導光的特性並結合偏光板的平板顯示器或其他電子導光光學設備
「LiDAR」	指	可見光偵測和定距，一種通過以激光瞄準物件或表面，並計量反射光返回接收器的時間以釐定距離的方法
「線性馬達」或「LRA」	指	一種振動馬達，使用音圈及彈簧負載的移動質量，通過在其共振頻率上振動，沿着單個軸產生觸覺反饋
「低延遲」	指	輸入或命令與相應的響應或動作之間的最小延遲或滯後

技術詞彙

「機器視覺傳感器」	指	一種用於從場景中擷取視覺數據，並將其轉換為數字信號，以執行自動化檢測、測量或識別任務的影像擷取裝置
「微控制單元」或「MCU」	指	一款包含一般用途的處理器核心、輸入／輸出界面及其他作多項應用的模組的芯片
「MEMS」	指	微機電系統，為一款精微尺寸下整合電子及機械元件的微型設備
「多光譜」	指	在電磁頻譜的多個區域內操作或涉及當中多個區域
「近紅外」	指	電磁波譜的一部分，肉眼不可見，但介於可見紅光與中紅外範圍之間
「神經網絡處理器」或「NPU」	指	一類特製硬件加速器或電腦系統，其設計目的為加快AI及機器學習應用，包括人工神經網絡及電腦視覺
「OEM」	指	「原始設備製造商」的英文縮寫，指一家公司按照客戶的規格生產產品，並以客戶品牌銷售有關產品
「光學防抖」或「OIS」	指	一種以相機鏡頭內的特別馬達結構驅動的機械影像穩定技術
「光學傳感器」	指	一種能探測光線並將其轉換為可供人類或電子儀器解讀的電子信號裝置。
「OLED」	指	有機發光二極管，為一種其放射性電致發光塗層為一層有機化合物薄膜，透過電流發光的發光二極管
「OLED Lux/CCT」	指	OLED所發出的光線照度值及相關色溫
「工藝設計套件」或「PDK」	指	晶圓廠提供的文件檔及數據叢集，讓芯片設計師設計及模擬特定製造流程使用的芯片
「光電二極管」	指	將光線轉為電流的半導體設備
「像素」	指	柵格圖象中最小可尋址元素

技術詞彙

「電源管理集成電路」 或「PMIC」	指	電源管理用的集成電路，電池推動設備（如手機、可攜式媒體播放器）及嵌入式設備（如路由器）通常都有配備，以降低所需空間
「PWM」	指	脈衝寬度調變訊號，一種透過改變載波中脈衝的寬度編碼類比資訊的數位訊號
「PWM波形」	指	PWM的波形
「研發」	指	研究及開發
「RISC-V」	指	以精簡指令集電腦原則為基礎的免費開放標準指令集架構
「機器人學」	指	機器人設計、建造、操作及使用的跨學科研究及實踐
「傳感器」	指	計量或偵測動作、熱力或光線等現實世界條件，並轉化為類比或數位按述的設備
「短波紅外線」或 「SWIR」	指	最接近可見光紅光波段的紅外線輻射範圍
「信號噪聲比」或 「SNR」	指	一項比較目標訊號強度與背景噪音強度的指標
「單光子雪崩二極管」 或「SPAD」	指	一種光電探測器，可探測到低強度信號直至單個光子
「SIP」	指	一種透過並列或堆疊的封裝方式，將多個功能芯片（例如處理器及記憶體）及各種電子元件整合至單個封裝內，從而於一個封裝中實現基本完整的功能單元的技術。
「智能音頻功放」	指	一種應用於智能裝置的音頻功放
「系統級芯片」 或「SoC」	指	一種整合計算機或其他電子系統中大部分或全部組件的集成電路。這些組件近乎必定包括芯片上的中央處理器、記憶界面、輸入或輸出設備、輸入或輸出界面，以及次級儲存界面，並通常與數傳電台等其他組件及一個圖像處理單元一併使用
「sq.m.」	指	平方米

技術詞彙

「流片」		將集成電路設計轉換為用於試產或製造的芯片的過程。流片是檢查芯片是否已達到設計預期功能及性能的過程
「飛時測距」或「ToF」	指	一種根據訊號發射與被物體反射後返回感測器之間的時間或相位差，以計量感測器與物件距離的方法。ToF可進一步分為直接飛行時間(dToF)和間接飛行時間(iToF)
「伏特」	指	伏特，電壓的單位
「驗證」	指	一種用於核實一個電路的正確性的方法，並評估及確認初始設計計劃，確保設計滿足下游客戶的需要，並符合設計方案
「虛擬實境」或「VR」	指	運用3D近眼顯示器及動作追蹤，讓用戶沉浸體驗虛擬世界的模擬體驗
「晶圓」	指	製造芯片所用的薄片半導體